

证券代码：874445

证券简称：科金明

主办券商：东兴证券

深圳市科金明电子股份有限公司

关于公司新增银行贷款授信公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、公司新增银行授信事项概述

深圳市科金明电子股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司惠州科金明电子有限公司（以下简称“惠州科金明”）为满足经营和发展的需要，公司已与招商银行股份有限公司深圳分行分别签署《授信协议》。

惠州科金明已与招商银行股份有限公司深圳分行《最高额不可撤销担保书》，由招商银行股份有限公司深圳分行向公司提供总计不超过 5,000 万元的综合授信。上述新增银行授信由惠州科金明提供无偿担保，担保范围以签署的《最高额不可撤销担保书》为准。具体情况如下：

单位：元

保证人	债权人	最高担保余额	担保类型	责任类型	是否履行必要的决策程序
惠州市科金明电子有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	50,000,000	保证	连带	是

二、表决和审议情况

公司于 2024 年 6 月 3 日召开的第二届董事会第十九次会议、2024 年 6 月 24

日召开的 2023 年年度股东大会分别审议通过了《关于申请银行综合授信额度并接受关联方担保的议案》，授权公司管理层向银行等金融机构申请总额不超过 3 亿元人民币的综合授信额度。

此次公司新增银行授信并由惠州科金明提供无偿关联担保系公司管理层在上述授权额度范围内使用，无需再另行召开董事会、股东大会审议。

三、担保事项对公司的影响

本次公司全资子公司惠州科金明为公司提供的担保风险可控，有利于满足公司生产经营和业务发展对流动资金的需求，改善公司现金流，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、备查文件目录

- （一）深圳市科金明电子股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议；
- （二）深圳市科金明电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （三）深圳市科金明电子股份有限公司第二届董事会第十九次独立董事意见；
- （四）意向书、协议或合同。

深圳市科金明电子股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日